

2011-2015年中国半导体材料行业运营状况分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国半导体材料行业运营状况分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xincailliao1106/Y575043Z69.html>

【报告价格】纸介版7800元 电子版8300元 纸介+电子8800元

【出版日期】2011-06-17

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国半导体材料行业运营状况分析与投资前景研究报告》共十七章。首先介绍了半导体材料行业相关概述、中国半导体材料产业运行环境等，接着分析了中国半导体材料行业的现状，然后介绍了中国半导体材料行业竞争格局。随后，报告对中国半导体材料行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体材料产业发展前景与投资预测。您若想对半导体材料产业有个系统的了解或者想投资半导体材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

2010年全球半导体制造装置市场规模比上年增长136%，达375亿4000万美元。设备投资额已经恢复到2004年的水平。预测2011年还将增长4%至389亿5000万美元。2012年预计将比2011年增长4%至405亿2000万美元。分地区来看，2010年的市场规模排名从高到低依次为台湾、韩国、北美、日本、其他、中国大陆、欧洲，该排名顺序将保持到2012年。2010年各地均为大幅增长，但接下来的2011-2012年大部分地区的增长将在10%以下。2011年台湾和韩国，2012年北美还会为负增长。从装置的种类来看，预测2010年晶圆工艺处理装置市场将比上年增长137%至281亿1000万美元，测试装置市场将比上年增长155%至39亿6000万美元，封装组装装置市场将比上年增长155%至35亿9000万美元，其他装置市场将比上年增长136%至18亿8000万美元。中国方面，“十二五”期间，我国半导体行业的投资有望超过2700亿元，较“十一五”增加1倍。我国将继续通过“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”支持集成电路产业，且支持力度还将加大。在政府的全方位扶持下，中国半导体产业将迎来一个“黄金时期”。

2010年北美和日本半导体设备订单出货比均呈上升趋势，未来半导体市场需求可期。由于IC出货量的持续增加，导致半导体材料用量已经回到近08年水平，但是预期2011年的增速减缓。2010年半导体前道材料将由09年的178.5亿美元(与08年相比下降26.2%)提高到217.1亿美元，仍未超过2008年241.9亿美元水平。在2010年中增长最快是硅片(32%up,达94.1亿美元)，紧接着是光刻胶(23%up,达11.3亿美元)及CMP的磨料/衬垫(21.7%up,达11.1亿美元)。由于硅片在09年下降达40%，所以2010年成为增长最快的项目。预计2010年硅片出货量增长31-32%。(Q2硅片按面积计出货量环比至少增长5%)其中200mm硅片市场需求在2007-2008下降后，目前由于模拟与分立器件的需求，已扭转下降趋势开始上升。甚至包括6英寸硅片需求在5月时也环比增长20%。在2010年增长最低，仅个位数的是湿法试剂(4.0%up,达9.41亿美元)，掩模(7.1%up,达29.3亿美元)及

溅射靶(9,8%up,达3.91亿美元)。其它类分别都在两位数以上。进入2010年中增长较慢,仅个位数增长的大类有(硅片,气体,掩模/光刻胶/光刻用辅助料),而在12%左右增长的有CMP,溅射靶。从半导体材料块看,在2010年封装材料无论是总的封装材料及大部分类别也能有低15%的增长。从上半年的订单已经超过2009的全年销售额。其中增长最快是封装用树脂及有机衬底材料。键合金线的出货量增长平稳,但是随着金价上升使其销售额迅速提高。2009年键合金线出货量增长5,9%,而2008年键合金线的销售额为39,68亿美元,2010年增长达10%及2011年达12-13%。预测2011年封装材料增长将下降到10%以下,而包括如硅片级封装WLP的介质材料及焊球的增长率都将在10%以上。

第一部分 行业发展现状

第一章 半导体材料行业发展概述

第一节 半导体材料的概述

一、 半导体材料的定义

二、 半导体材料的分类

三、 半导体材料的特点

四、 化合物半导体材料介绍

第二节 半导体材料特性和制备

一、 半导体材料特性和参数

二、 半导体材料制备

第三节 产业链结构及发展阶段分析

一、 半导体材料行业的产业链结构

二、 半导体材料行业发展阶段分析

三、 2010-2011年行业所处周期分析

第二章 全球半导体材料行业发展分析

第一节 世界总体市场概况

一、 全球半导体材料的进展分析

二、 全球半导体材料市场发展现状

三、 第二代半导体材料砷化镓发展概况

四、 第三代半导体材料GaN发展概况

第二节 世界半导体材料行业发展分析

一、 2010年世界半导体材料行业发展分析

二、2011年世界半导体材料行业发展分析

三、2011年半导体材料行业国外市场竞争分析

第三节 2010-2011年主要国家或地区半导体材料行业发展分析

一、2010-2011年美国半导体材料行业分析

二、2010-2011年日本半导体材料行业分析

三、2010-2011年德国半导体材料行业分析

四、2010-2011年法国半导体材料行业分析

五、2010-2011年韩国半导体材料行业分析

六、2010-2011年台湾半导体材料行业分析

第三章 我国半导体材料行业发展分析

第一节 2010年中国半导体材料行业发展状况

一、2010年半导体材料行业发展状况分析

二、2010年中国半导体材料行业发展动态

三、2010年半导体材料行业经营业绩分析

四、2010年我国半导体材料行业发展热点

第二节 2011年半导体材料行业发展机遇和挑战分析

一、2011年半导体材料行业发展机遇分析

二、2011年金融危机对半导体材料行业影响

第三节 2011年中国半导体材料市场供需状况

一、2011年中国半导体材料行业供给能力

二、2011年中国半导体材料市场供给分析

三、2011年中国半导体材料市场需求分析

四、2011年中国半导体材料产品价格分析

第四章 半导体材料产业经济运行分析

第一节 营运能力分析

一、2010年营运能力分析

二、2011年营运能力分析

第二节 偿债能力分析

一、2010年偿债能力分析

二、2011年偿债能力分析

第三节 2010-2011年盈利能力分析

一、2010-2011年资产利润率

二、2010-2011年销售利润率

第四节 2010-2011年发展能力分析

一、2010-2011年资产年均增长率

二、2010-2011年利润增长率

第五章 半导体产业分析

第一节 全球半导体行业发展分析

一、2010年全球半导体厂商竞争情况

二、2011年全球半导体厂商竞争情况

三、2010年全球半导体行业发展分析

四、2010年金融危机对行业影响分析

五、2011年全球半导体行业发展形势

第二节 中国半导体产业发展分析

一、2010年中国半导体采购情况分析

二、2010年中国半导体市场增长分析

三、2010年中国半导体市场规模分析

四、2010年中国半导体行业投资分析

五、2011年中国半导体行业发展形势

第三节 半导体照明行业发展分析

一、2010年中国半导体照明产业数据

二、2010年中国半导体照明产业分析

三、半导体照明市场应用前景分析

四、七大半导体照明产业发展规划

第四节 半导体设备行业发展分析

一、2010年全球半导体设备的出货额

二、2011年全球半导体设备销售预测

三、2010年本土半导体设备发展分析

四、2011年半导体设备市场增长预测

第五节 半导体行业发展预测

一、2010年全球半导体材料市场预测

- 二、2010年中国半导体材料发展前景
- 三、2005-2010年半导体行业的复合增长率
- 四、2010-2011年半导体材料市场增长预测

第六章 主要半导体材料发展分析

第一节 硅晶体

- 一、国内外多晶硅产业概况
- 二、单晶硅和外延片发展概况
- 三、中国硅晶体材料产业特点
- 四、我国多晶硅产业发展现状分析
- 五、2011-2010年多晶硅行业发展趋势

第二节 砷化镓

- 一、砷化镓产业发展概况
- 二、砷化镓材料发展概况
- 三、我国砷化镓产业链发展情况分析
- 四、砷化镓产业需求分析

第三节 GaN

- 一、GaN材料的特性与应用
- 二、GaN的应用前景
- 三、GaN市场发展现状
- 四、GaN产业市场投资前景

第四节 碳化硅

- 一、碳化硅概况
- 二、碳化硅生产企业分析
- 三、国内碳化硅晶体发展情况
- 四、2011-2010年碳化硅市场发展趋势

第五节 其他半导体材料

- 一、非晶半导体材料概况
- 二、宽禁带氮化镓材料发展概况
- 三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第七章 主要半导体市场分析

第一节 LED产业发展

- 一、全球LED产业发展概况
- 二、中国LED产业发展概况
- 三、我国半导体照明市场应用情况
- 四、2010年LED产业资源整合分析
- 五、2011-2010年中国LED产业发展预测

第二节 电子元器件市场

- 一、我国电子元器件产业发展前景分析
- 二、电子元件产业升级分析
- 三、2010年电子元器件收入利润分析
- 四、2011年电子元器件市场渠道供应趋势分析
- 五、2010年电子元器件市场预测

第三节 集成电路

- 一、2010年半导体集成电路产量分析
- 二、2010年中国集成电路市场运行分析
- 三、2010年集成电路产业的总体发展趋势
- 四、2011年我国集成电路市场规模预测
- 五、未来集成电路技术发展趋势

第四节 半导体分立器件

- 一、2010年半导体分立器件产量分析
- 二、2010年半导体器件进出口分析
- 三、2011年半导体分立器件市场发展态势
- 四、2011年半导体分立器件市场预测

第五节 其他半导体市场

- 一、半导体气体与化学品产业发展概况
- 二、IC光罩市场发展概况

第二部分 行业竞争格局

第八章 半导体材料产业发展地区比较

第一节 长三角地区

- 一、竞争优势
- 二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第九章 半导体材料行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 半导体材料制造业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业出口交货值对比分析

五、重点企业利润总额对比分析

六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2010-2011年半导体材料行业竞争格局分析

一、2010年半导体材料制造业竞争分析

二、2010年中外半导体材料产品竞争分析

三、2010-2011年国内外半导体材料竞争分析

四、2010-2011年我国半导体材料市场竞争分析

五、2010-2011年我国半导体材料市场集中度分析

六、2011-2015年国内主要半导体材料企业动向

第十章 半导体材料企业竞争策略分析

第一节 半导体材料市场竞争策略分析

一、2011年半导体材料市场增长潜力分析

二、2011年半导体材料主要潜力品种分析

三、现有半导体材料产品竞争策略分析

四、潜力半导体材料品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 半导体材料企业竞争策略分析

一、金融危机对半导体材料行业竞争格局的影响

二、金融危机后半导体材料行业竞争格局的变化

三、2011-2015年我国半导体材料市场竞争趋势

四、2011-2015年半导体材料行业竞争格局展望

五、2011-2015年半导体材料行业竞争策略分析

六、2011-2015年半导体材料企业竞争策略分析

第十一章 主要半导体材料企业竞争分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第二节 天津中环半导体股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第三节 峨嵋半导体材料厂

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第四节 四川新光硅业科技有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第五节 洛阳中硅高科技有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第六节 宁波立立电子股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第七节 宁波康强电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第八节 南京国盛电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第三部分 行业前景预测

第十二章 半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2011年发展环境展望

- 一、2011年宏观经济形势展望
- 二、2011年政策走势及其影响
- 三、2011年国际行业走势展望

第二节 2011年半导体材料行业发展趋势分析

- 一、2011年技术发展趋势分析
- 二、2011年产品发展趋势分析
- 三、2011年行业竞争格局展望

第三节 主要半导体材料的发展趋势

- 一、硅材料
- 二、GaAs和InP单晶材料
- 三、半导体超晶格、量子阱材料
- 四、一维量子线、零维量子点半导体微结构材料
- 五、宽带隙半导体材料
- 六、光子晶体
- 七、量子比特构建与材料

第四节 2011-2015年中国半导体材料市场趋势分析

- 一、2010-2011年半导体材料市场趋势总结
- 二、2011-2015年半导体材料发展趋势分析
- 三、2011-2015年半导体材料市场发展空间

- 四、2011-2015年半导体材料产业政策趋向
- 五、2011-2015年半导体材料技术革新趋势
- 六、2011-2015年半导体材料价格走势分析

第十三章 未来半导体材料行业发展预测

第一节 2011-2015年国际半导体材料市场预测

- 一、2011-2015年全球半导体材料行业产值预测
- 二、2011-2015年全球半导体材料市场需求前景
- 三、2011-2015年全球半导体材料市场价格预测

第二节 2011-2015年国内半导体材料市场预测

- 一、2011-2015年国内半导体材料行业产值预测
- 二、2011-2015年国内半导体材料市场需求前景
- 三、2011-2015年国内半导体材料市场价格预测

第三节 2011-2015年市场消费能力预测

- 一、2011-2015年行业总需求规模预测
- 二、2011-2015年主要产品市场规模预测
- 三、2011-2015年市场供应能力预测

第四部分 投资战略研究

第十四章 半导体材料行业投资现状分析

第一节 2010年半导体材料行业投资情况分析

- 一、2010年总体投资及结构
- 二、2010年投资规模情况
- 三、2010年投资增速情况
- 四、2010年分行业投资分析
- 五、2010年分地区投资分析
- 六、2010年外商投资情况

第二节 2011年1季度半导体材料行业投资情况分析

- 一、2011年1季度总体投资及结构
- 二、2011年1季度投资规模情况
- 三、2011年1季度投资增速情况
- 四、2011年1季度分行业投资分析

五、2011年1季度分地区投资分析

六、2011年1季度外商投资情况

第十五章 半导体材料行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2010-2011年我国宏观经济运行情况

二、2011-2015年我国宏观经济形势分析

三、2011-2015年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2011年半导体材料行业政策环境

二、2011年国内宏观政策对其影响

三、2011年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2011年社会环境发展分析

三、2011-2015年社会环境对行业的影响分析

第四节 电子产业信息振兴规划

一、电子产业信息振兴规划概述

二、电子产业信息振兴规划细则

三、电子产业信息振兴规划三大任务

四、电子产业信息振兴规划六大工程

五、电子产业信息振兴规划十项措施

六、电子产业信息振兴规划的意义与作用

七、电子产业信息振兴规划对半导体材料行业的影响

第十六章 半导体材料行业投资机会与风险

第一节 行业活力系数比较及分析

一、2011年相关产业活力系数比较

二、2009-2010行业活力系数分析

第二节 行业投资收益率比较及分析

一、2011年相关产业投资收益率比较

二、2009-2010行业投资收益率分析

第三节 半导体材料行业投资效益分析

- 一、2010-2011年半导体材料行业投资状况分析
- 二、2011-2015年半导体材料行业投资效益分析
- 三、2011-2015年半导体材料行业投资趋势预测
- 四、2011-2015年半导体材料行业的投资方向
- 五、2011-2015年半导体材料行业投资的建议
- 六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节 影响半导体材料行业发展的主要因素

- 一、2011-2015年影响半导体材料行业运行的有利因素分析
- 二、2011-2015年影响半导体材料行业运行的稳定因素分析
- 三、2011-2015年影响半导体材料行业运行的不利因素分析
- 四、2011-2015年我国半导体材料行业发展面临的挑战分析
- 五、2011-2015年我国半导体材料行业发展面临的机遇分析

第五节 半导体材料行业投资风险及控制策略分析

- 一、2011-2015年半导体材料行业市场风险及控制策略
- 二、2011-2015年半导体材料行业政策风险及控制策略
- 三、2011-2015年半导体材料行业经营风险及控制策略
- 四、2011-2015年半导体材料行业技术风险及控制策略
- 五、2011-2015年半导体材料同业竞争风险及控制策略
- 六、2011-2015年半导体材料行业其他风险及控制策略

第十七章 半导体材料行业投资战略研究

第一节 半导体材料行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第二节 对我国半导体材料品牌的战略思考

- 一、企业品牌的重要性

- 二、半导体材料实施品牌战略的意义
 - 三、半导体材料企业品牌的现状分析
 - 四、我国半导体材料企业的品牌战略
 - 五、半导体材料品牌战略管理的策略
- 第三节 半导体材料行业投资战略研究
- 一、2011年电子信息产业投资战略
 - 二、2011年半导体材料行业投资战略
 - 三、2011-2015年半导体材料行业投资战略
 - 四、2011-2015年细分行业投资战略

图表目录

- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标全国合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标北京市合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标天津市合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标河北省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标山西省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标内蒙古合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标辽宁省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标吉林省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标黑龙江合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标上海市合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标江苏省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标浙江省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标安徽省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标福建省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标江西省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标山东省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标河南省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标湖北省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标湖南省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标广东省合计
- 图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标广西区合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标海南省合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标重庆市合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标四川省合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标云南省合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标陕西省合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标甘肃省合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标青海省合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标宁夏区合计

图表：2010年1-12月半导体材料行业主要经济指标新疆区合计

图表：2010年2月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2010年5月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2010年8月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2010年11月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标全国合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标北京市合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标天津市合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标河北省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标山西省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标内蒙古合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标辽宁省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标吉林省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标黑龙江合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标上海市合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标江苏省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标浙江省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标安徽省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标福建省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标江西省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标山东省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标河南省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标湖北省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标湖南省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标广东省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标广西区合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标海南省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标重庆市合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标四川省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标云南省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标陕西省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标甘肃省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标青海省合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标宁夏区合计

图表：2011年1-3月半导体材料行业主要经济指标新疆区合计

图表：2011年1月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2011年2月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2011年3月半导体材料行业收入前十家企业

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量全国合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量北京市合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量天津市合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量河北省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量山西省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量辽宁省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量吉林省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量黑龙江合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量上海市合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量江苏省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量浙江省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量安徽省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量福建省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量江西省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量山东省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量河南省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量湖北省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量湖南省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量广东省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量广西区合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量海南省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量重庆市合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量四川省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量贵州省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量云南省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量陕西省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量甘肃省合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量新疆区合计

图表：2010年1-12月半导体分立器件产量内蒙古合计

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子元件行业协会、中国产业研究报告网、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对国内外半导体材料行业的发展状况进行了深入透彻地研究，对我国半导体材料主要市场发展情况、投资机会作了详尽分析。报告重点分析了下游半导体行业发展情况，报告还对国内重点半导体材料企业及未来半导体材料发展趋势进行了分析，是半导体材料及相关制造企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握半导体材料行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xincailliao1106/Y575043Z69.html>